







WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM PCT

Internationale Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 91/03734

G01N 27/12

A1

Veröffentlichungsdatum:

21. März 1991 (21.03.91)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/AT90/00084

(22) Internationales Anmeldedatum: 29. August 1990 (29.08.90)

(30) Prioritätsdaten:

A 2033/89 A 571/90

29. August 1989 (29.08.89) 9. März 1990 (09.03.90)

AT AT

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM TECHNIK GESELLSCHAFT M.B.H. [AT/AT]; Fabrikgasse 13, A-8700 Leoben (AT). LENZING AKTIENGESELL-SCHAFT [AT/AT]; Werkstraße 2-4, A-4860 Lenzing (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erlinder; und
(75) Erlinder/Anmelder (nur für US): MITTER, Helmut [AT/AT]; Waldsiedlung 12, A-4202 Hellmansödt (AT). SCHARIZER, Walter [AT/AT]; Haid 51, A-4210 Gallneukirchen (AT). SÖLLRADL, Herbert [AT/DE]; Forststraße 27, D-8261 Emmerting (DE). ROSSAK, Norbert [AT/AT]; Welsern 22, A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla (AT).

(74) Anwälte: KRETSCHMER, Adolf usw.; Schottengasse 3a, A-1014 Wien (AT).

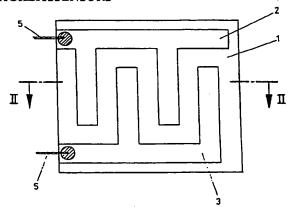
(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), ES (europäisches Pa päisches Patent), FI, FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), SE (europäisches Patent) päisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: USE OF A SWELLABLE PLASTIC AND PROCESS FOR MAKING A RESISTIVE MOISTURE SENSOR

(54) Bezeichnung: VERWENDUNG EINES QUELLFÄHIGEN KUNSTSTOFFES, SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTEL-LUNG EINES RESISTIVEN FEUCHTIGKEITSSENSORS



(57) Abstract

The use of a swellable plastic in which additives like carbon, metal particles or the like are dispersed is proposed for the manufacture of a resistive moisture sensor. In a process for making such a resistive moisture sensor, swellable plastics, especially polyimides and/or copolyimides, are dissolved in a polar solvent like N-methyl pyrrolidone, whereafter conductivity additives like soot are dispersed in the solution and uniformly distributed and then the solution is applied to an inert substrate (1) and dried.

(57) Zusammenfassung

Zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors wird die Verwendung eines quellfähigen Kunststoffes, in welchem zur Verbesserung der Leitfähigkeit Zusätze, wie Kohlenstoff, Metallstaub od.dgl., dispergiert sind, vorgeschlagen. Bei einem Verfahren zur Herstellung eines derartigen resistiven Feuchtigkeitssensors werden quellfähige Kunststoffe, insbesondere Polyimide und/oder Copolyimide, in einem polaren Lösungsmittel, wie z.B. N-Methylpyrrolidon, gelöst, worauf Leitfähigkeitszusätze, wie z.B. Ruß, in der Lösung dispergiert und homogen verteilt werden und anschließend die Lösung auf einen inerten Träger (1) aufgebracht und getrocknet wird.

BENENNUNGEN VON "DE"

Bis auf weiteres hat jede Benennung von "DE" in einer internationalen Anmeldung, deren internationaler Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt, Wirkung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Gebietes der früheren DDR.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österroich	ES	Spanion	MG	Madagaskar
AU	Australien	Fì	Finnland	ML	Mali
₽B	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanion
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BF	Burkina Fasso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BJ	Benin	HU	Ungarn	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	RO	Rumänien
CA	Kanada	JP	Japan	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CC	Kongo	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz .	Ll	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
DE	Deutschland	LU	Luxemburg	TG	Togo
DK	Dinemark	MC	Monac	oUS	Vereinigte Staaten von Amerika

WO 91/03734 PCT/AT90/00084

- 1 -

<u>Verwendung eines quellfähigen Kunststoffes, sowie Verfahren</u> <u>zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors</u>

Die Erfindung bezieht sich auf die Verwendung eines quell5 fähigen Kunststoffes, in welchem zur Verbesserung der Leitfähigkeit Zusätze, wie Kohlenstoff, z.B. Ruß, Metallstaub
od.dgl., dispergiert sind, zur Herstellung eines resistiven
Feuchtigkeitssensors, sowie ein Verfahren zur Herstellung
eines derartigen resistiven Feuchtigkeitssensors.

10

Resistive Feuchtigkeitssensoren, d.h. Feuchtesensoren, die einen elektrischen Widerstand in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit ändern, sind mit Metall- oder Halbleiteroxiden feuchtigkeitsempfindlichem Material bekannt. Die 15 nannten feuchtigkeitsempfindlichen Materialien kommen hauptsächlich in Form von Sinterkörpern, Keramik, Folien, gebrannten Dickschichtpasten und chemisch abgeschiedenen zur Feuchtigkeitssensoren Anwendung. Derartige zeichnen sich in den genannten Ausführungsformen durch hohe 20 Empfindlichkeit, d.h. hohe Widerstandsänderung bei Änderung der Feuchtigkeit aus, sind aber nur in geringem Ausmaß stabil und weisen ein relativ träges Ansprechverhalten und insbesondere lange Ansprechzeiten auf. Da das feuchtigkeitsaufnehmende Volumen derartiger Sensoren verhältnismäßig groß 25 ist, läßt sich die träge Ansprechcharakteristik verstehen.

Metall- oder Halbleiteroxid-Feuchtigkeitssensoren weisen darüberhinaus im allgemeinen eine stark nicht-lineare Widerstands-Feuchtigkeits-Charakteristik sowie relativ große Widerstände auf, was den Aufwand in der Auswerteelektronik erhöht. Sensoren der eingangs genannten Art sind beispielsweise aus der DE-PS 16 98 096, DE-OS 27 28 092, der DE-OS 30 24 297, der US-PS 3 453 143 und der DE-AS 29 38 434 zu entnehmen.

Die Erfindung zielt nun darauf ab, einen resistiven Feuchtesensor zur Verfügung zu stellen, welcher in einfacher Weise herstellbar ist und sich durch gute Linearität der Widerstands-Feuchte-Charakteristik, sowie ein für die Auswertung 5 besonders geeignetes Widerstandsniveau auszeichnet. Erfindungsgemäß wird hiezu vorgeschlagen, einen quellfähigen Kunststoff, in welchem zur Verbesserung der Leitfähigkeit Zusätze wie Kohlenstoff, Metallstaub od.dgl., dispergiert sind, zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors 10 zu verwenden. Quellfähige Kunststoffe, wie beispielsweise Polyimide, sind im Zusammenhang mit kapazitiven Feuchtigkeitssensoren bereits vorgeschlagen worden. Daß sich quellfähige Kunststoffe mit entsprechenden, die Leitfähigkeit erhöhenden Zusätzen für die Herstellung von resistiven 15 Feuchtigkeitssensoren eignen, lag in keiner Weise nahe. Der Mechanismus für die Funktion eines derartigen quellfähigen Kunststoffes als Matrix für die Leitfähigkeit erhöhende Zusätze zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors ist keineswegs vollständig geklärt. Die überraschend als 20 relativ linear beobachtete Widerstands-Feuchtigkeits-Charakteristik wird darauf zurückgeführt, daß durch das Quellen des quellfähigen Kunststoffes bei zunehmender Feuchtigkeit der relative Abstand der die Leitfähigkeit erhöhenden Zusätze vergrößert wird, so daß eine positive Widerstandsänderung mit 25 steigender Feuchte beobachtet wird. Die Verwendung einer Polymermatrix aus quellfähigem Kunststoff hat hiebei den Vorteil, daß mit relativ dünnen Schichten gearbeitet werden kann, wodurch die Ansprechgeschwindigkeit wesentlich gesteigert werden kann, wobei die Tatsache, daß die Grund-30 leitfähigkeit durch Zusätze, wie Kohlenstoff, Metallstaub od.dgl., erzielt wird, die Möglichkeit bietet, resistive Feuchtigkeitssensoren mit für nachgeschaltete Auswerteelektroniken günstigen Widerstandswerten zu erzeugen, wobei der Widerstandswert in weiten Grenzen einstellbar ist. 35 Überraschend ist vor allem neben der im wesentlichen linearen positiven Widerstandscharakteristik die hohe Ansprech-

geschwindigkeit, welche eine deutliche Verbesserung besonders einfacher Herstellung des Feuchtigkeitssensors mit sich bringt. Mit Vorteil werden für die Herstellung derartiger resistiver Feuchtigkeitssensoren als quellfähiger 5 Kunststoff Polyimide, Copolyimide, Aramide, Polyamide, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polycarbonate, Polysulfone oder Polyethylen eingesetzt, wobei in bevorzugter Weise Leitfähigkeitszusätze bis zu 50 Gew.-% Graphit oder 3 bis 15 Gew.-% Ruß mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 10 100 m²/g, insbesondere etwa 1000 m²/g eingesetzt werden. Ein hohes Maß an Stabilität und eine hohe Linearität der Widerstands-Feuchtigkeitscharakteristik läßt sich dadurch zielen, daß die Leitfähigkeitszusätze mit Dispergiermitteln, wie z.B. Siloxanen, eingebracht werden und eine maximale 15 Teilchengröße von 25 μm aufweisen.

Prinzipiell kann ein derartiger quellfähiger Kunststoff in konventioneller Weise auf ein entsprechendes isolierendes Trägermaterial aufgebracht werden, um die mechanische Stabi-20 lität sicherzustellen. Die Sensormasse kann hiebei nach dem homogenen Einbringen von Leitfähigkeitszusätzen Schleudern, Tauchen oder Sprühen oder auch Streichen, Drücken od.dgl. aufgebracht werden, wobei insbesondere im Falle der bevorzugten Verwendung von Polyimiden als quellfähigem 25 Kunststoff ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung eines derartigen resistiven Feuchtigkeitssensors im wesentlichen darin besteht, daß quellfähige Kunststoffe, insbesondere Polyimide und/oder Copolyimide in einem polaren Lösungsmittel, wie z.B. N-Methylpyrrolidon, gelöst werden, 30 daß hierauf Leitfähigkeitszusätze, wie z.B. Ruß, Lösung dispergiert und homogen verteilt werden, und daß anschließend die Lösung auf einen inerten Träger aufgebracht wird und anschließend getrocknet wird. Für die Lösung von Polyimiden und/oder Copolyimiden in polaren Lösungsmitteln 35 können hiebei auch bereits vollständig imidisierte Materia-

lien Verwendung finden, wodurch sich besonders homogene und

entsprechend dünne Schichten mit entsprechend großer sprechgeschwindigkeit erzielen lassen. Die Verwendung polarer Lösungsmittel, welche durch Trocknen entfernt werden können, erlaubt es in einfacher Weise, homogene und dünne Schichten aus quellfähigen Kunststoffen mit den zuvor eingebrachten, die Leitfähigkeit erhöhenden Zusätzen auf einen mechanisch stabilen, inerten Träger aufzubringen. Als isolierendes Trägermaterial kann hiebei in konventioneller Weise Glas, Keramik, oxidierte Silizium-Wafer od.dgl., eingesetzt werden, 10 wobei die Verwendung von Polyimiden in vollständig imidisiertem Zustand in einem polaren Lösungsmittel beliebige Schichtstärken mit vollständiger Homogenität erzielen läßt, da beim nachfolgenden Entfernen, insbesondere Abdampfen des Lösungsmittels, keine chemische Reaktion in der Beschichtung abläuft 15 und dadurch die Gefahr der Ausbildung von Inhomogenitäten in der Oberfläche vermieden wird. Auf diese Weise lassen sich auch bei extrem kleinen Schichtstärken reproduzierbare Widerstandswerte einstellen. Mit Vorteil wird erfindungsgemäß die Trocknung so vorgegangen, daß die Trocknung 20 wenigstens zwei Stufen vorgenommen wird, wobei in der ersten Stufe bei Temperaturen zwischen 80° und 140°C, insbesondere 120°C, und in jeder weiteren Stufe bei einer um 50 bis 80°C erhöhten Temperatur getrocknet wird, wodurch eine homogene und glatte Oberfläche erzielt wird, welche ein reproduzier-25 bares Ansprechverhalten bei im wesentlichen gleichbleibender Grundeinstellung des Widerstandswertes erzielen läßt. Falle von resistiven Feuchtigkeitssensoren entfällt die für kapazitive Sensoren erforderliche, feuchtigkeitsdurchlässige Deckelektrode, so daß vergleichsweise besonders kurze An-30 sprechzeiten möglich werden. Als polares Lösungsmittel kann im Falle von Polyimiden mit Vorteil Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon Sulfolan verwendet werden, wobei eine vollständige Lösung in einem derartigen polaren Lösungsmittel dann sichergestellt 35 werden kann, wenn als Polyimid ein Copolymeres aus 3,3',4,4'--Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid und 60 bis 100 Mol.%

Toluylendiamin (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) oder Toluylendiisocyanat (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) und 0 bis 40 % Mol.% 4,4-Methylenbis(phenylamin) oder 4,4'-Methylenbis-(phenylisocyanat) und insbesondere ein lineares Polyimid mit einem Gewichtsmittel von 30000 bis 300000 Einheiten und einem Zahlenmittel von 10000 bis 60000 eingesetzt wird. Ein derartiges lineares Polyimid kann aus der Lösung durch Tauchen, Sprühen oder Schleudern aufgebracht werden und es wird auf diese Weise sichergestellt, daß die aufgebrachte Schicht über die gesamte Fläche gleichmäßig dick und pinholefrei ist, wobei die Schichten mit bedeutend geringerer Dicke aufgebracht werden können, was insbesondere im Hinblick auf die Ansprechgeschwindigkeit von besonderer Bedeutung ist.

15 Als lineares Polyimid mit besonders hoher Empfindlichkeit und gegenüber Polyimidfilmen herkömmlichen verbessertem sprechverhalten wurde ein Copolymer aus 3,3',4,4'-Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid und 60 bis 100 Mol.% Toluylendiamin (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) oder Toluylen-20 diisocyanat (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) und 0 bis 40 % Mol.% 4,4-Methylenbis(phenylamin) oder 4,4'-Methylenbis-(phenylisocyanat) aufgefunden. Die Verwendung eines derartigen Copolymers, insbesondere eines derartigen statistischen Copolymers mit einem Gewichtsmittel von 30000 bis 300000 25 Einheiten und einem Zahlenmittel von 10000 bis 60000 Einheiten, zeichnet sich dadurch aus, daß es in den oben genannten stark polaren Lösungsmitteln ohne weiteres löslich ist, wobei die Haftung und insbesondere die Gefahr eines Verrutschens oder Ablösens der nach dem Trocknen ausgebildeten 30 Polyimidschicht vom Trägermaterial mit Sicherheit dadurch verhindert werden kann, daß vor dem Auftragen der Polyimidschicht ein Haftvermittler, insbesondere organofunktionelle Silane mit einer oder mehreren funktionellen Endgruppen (so z.B. Aminopropyltriethoxysilan, Aminoethylaminopropyl-35 trimethoxysilan oder 3-Glycidoxypropyltriethoxysilan etc.),

aufgebracht wird. Derartige organofunktionelle Silane sind

einfach verarbeitbar und zeigen zu üblicherweise verwendeten Trägermaterialien, wie Glas, Keramik, Metall od.dgl., ebenso wie zu den für die Herstellung der feuchtigkeitsempfindlichen Schicht verwendeten linearen löslichen Polyimiden eine große Affinität. Durch die gute Löslichkeit derartiger organofunktioneller Silane sowohl in wässrigen als auch nicht wässrigen Lösungsmitteln lassen sich insbesondere durch Tauchen, Sprühen oder Schleudern extrem dünne Schichten des Haftvermittlers auf dem Trägermaterial aufbringen, so daß die 10 Gesamtdicke des Sensors durch den Haftvermittler nur unwesentlich vergrößert wird.

Die vollständige Entfernung des polaren Lösungsmittels in mehreren Stufen in den angeführten Temperaturbereichen ergibt eine dünne, homogene Polyimidschicht auf dem Träger und eine gleichmäßige Durchtrocknung des Polyimids über die gesamte Fläche und Tiefe des Bauteiles. Gleichzeitig wird mit einer derartigen Temperaturbehandlung überraschenderweise eine weitere Linearisierung der Widerstands-Feuchtigkeits-Charakteristik erzielt, wobei mit Vorteil die maximale Trocknungstemperatur kleiner 280°C, vorzugsweise mit etwa 260°C, gewählt wird.

Um den Aufwand für die nachfolgende Auswerteschaltung gering 25 zu halten, wird mit Vorteil der spezifische Widerstand des leitfähigen, quellfähigen Kunststoffes auf 0,5 Ω cm bis 50 k Ω cm, insbesondere 5 Ω cm bis 30 k Ω cm eingestellt.

Nach der auf diese Weise vorgenommenen Konditionierung des 30 Polymers durch Trocknung, Erstarrung bzw. gegebenenfalls Ausheilung können die zuvor am Träger vorgesehenen Anschlußkontakte mechanisch, mittels Laser oder durch Plasmaätzen freigelegt werden und der Sensor mit Anschlußdrähten kontaktiert werden.

- 7 -

Die Aufbringung der Polymermatrix kann hiebei unmittelbar auf den Träger oder gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines Haftvermittlers erfolgen, wobei für resistive Sensoren die Elektrodenstruktur auch anschließend über das Polymer durch Aufdampfen oder Sputtern hergestellt werden kann und gegebenenfalls photolithographisch strukturiert werden kann. Bei einer derartigen Ausführung müssen die Anschlußkontakte nicht mehr vom Polymer befreit werden, so daß die Strukturierung des Polymers entfallen kann.

10

Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von in der Zeichnung schematisch dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. In dieser zeigen: Fig.1 eine Draufsicht auf eine erste Ausbildungsform eines erfindungsgemäßen Feuchtesensors; 15 Fig.2 einen Schnitt nach der Linie II-II durch den Sensor der Fig.1, und Fig.3 eine abgewandelte Ausführungsform in einer zu Fig.2 analogen Darstellung.

In Fig.1, 2 und 3 ist mit 1 ein isolierender Träger be20 zeichnet, welcher beispielsweise aus Glas, Keramik, oxidiertem Silizium-Wafer oder anderen elektrisch isolierenden
organischen oder anorganischen Trägermaterialien bestehen
kann. Auf den gereinigten und getrockneten Träger 1 werden
mittels eines Kathoden-Zerstäubungsverfahrens in einem Prozeß
25 zuerst eine Schicht NiCr mit einer Stärke von 200 nm und
anschließend eine Schicht Au mit einer Schichtstärke von
150 nm aufgebracht. Diese NiCr-Au-Schicht wird daran anschließend in Form von ineinandergreifenden Kammelektroden
2 und 3 photolithographisch strukturiert.

30

Auf die gereinigte und getrocknete, gegebenenfalls mit einem Haftvermittler behandelte Oberfläche des mit den Elektroden 2 und 3 versehenen Substrats bzw. Trägers wird die Lösung eines im voll imidisierten Zustand noch in polaren Lösungsmitteln 35 löslichen Polyimids oder Copolyimids aufgebracht, welches durch Zugabe von etwa 6% Ruß, bezogen auf den Polyimidanteil

in der Lösung leitfähig gemacht wurde und anschließend getrocknet.

Die dünne Polymerschicht 4 wird anschließend über den An-5 schlußflächen der Elektrode entweder mechanisch oder durch Plasmaätzen oder mittels Laser entfernt, um ein Kontaktieren der Elektroden 2, 3 mit Anschlußdrähten 5 zu ermöglichen.

Für die durch Zusatz von Ruß oder Graphit leitfähig gemachte 10 Polyimidschicht 4 wird ein lineares Copolymer aus 3,3',4,4'--Benzophenontetracarbonsäuredianhydrid und 60 bis 100 Mol.% Toluylendiamin (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) oder Toluylendiisocyanat (2,4- und/oder 2,6-Isomeres) und 0 bis 40 % Mol.% 4,4'-Methylenbis(phenylamin) oder 4,4'-Methylenbis-(phenyl-15 isocyanat) in einem stark polaren Lösungsmittel wie beispielsweise Dimethylformamid, Dimethylacetamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon oder Sulfolan eingesetzt. Nach dem Aufbringen eines derartigen statistischen Copolymers mit einem Gewichtsmittel von 30000 bis 300000 Einheiten und einem 20 Zahlenmittel von 10000 bis 60000 wurde das Polyimid bei Temperaturen von über 105°C bis maximal 280°C ansteigend getrocknet, wobei in drei Stufen getrocknet wurde und in jeder der drei Stufen die Temperatur gegenüber der zuvor herrschenden Temperatur um jeweils 50 bis 80°C erhöht wurde. Die 25 Trocknung erfolgte beispielsweise bei 120°C, 190°C 260°C.Das lineare Polyimid wurde der Lösung aus Tauchen, Sprühen oder Schleudern aufgebracht. Prinzipiell ist die Verarbeitung des linearen statistischen Copolyimids für die Herstellung der Polyimidschicht 4 direkt aus der bei der 30 Polykondensation erhaltenen Lösung möglich. Ebenso kann aber das Polyimid zuvor ausgefällt, getrocknet und gelagert werden

Bei der Ausführungsform gemäß Fig.3 wird auf die gereinigte 35 und getrocknete, gegebenenfalls mit einem Haftvermittler behandelte Oberfläche des Substrats bzw. Trägers 1 die mit

und erst bei Bedarf eine geeignete Lösung hergestellt werden.

- 9 -

Ruß bzw. Graphit leitfähig gemachte Lösung des Polyimids wiederum durch Schleudern aufgebracht und in einem Umluftofen in drei Stufen bei etwa 120°C, 190°C und 260°C getrocknet.

Auf die so hergestellte leitfähige, dünne Polyimidschicht 4 wird nachfolgend mittels eines Zerstäubungsverfahrens in einem Prozeß zuerst eine Schicht NiCr mit einer Stärke von 200 nm und anschließend eine Schicht Au mit einer Schichtstärke von 150 nm aufgebracht. Diese NiCr-Au-Schicht wird nachfolgend ebenfalls in Form von ineinandergreifenden Kammelektroden 2, 3 photolithographisch strukturiert und mit Anschlußdrähten kontaktiert.

Besonders geringe Schichtstärken und damit hohe Ansprech- 15 geschwindigkeit sind durch Schleudern und Drücken erhältlich, wobei ein Dickenbereich von 0,3 μ m bis 10 μ m, vorzugsweise 0,5 μ m bis 2 μ m, in Betracht kommt.

20

25

30

Patentansprüche:

- Verwendung eines quellfähigen Kunststoffes, in welchem zur Verbesserung der Leitfähigkeit Zusätze, wie Kohlenstoff,
 Metallstaub od.dgl., dispergiert sind, zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 als quellfähiger Kunststoff Polyimide, Copolyimide, Aramide,
 Polyamide, Polyacrylate, Polymethacrylate, Polycarbonate,
 Polysulfone oder Polyethylen eingesetzt werden.
- Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Leitfähigkeitszusätze bis zu 50 Gew.-% Graphit oder 3
 bis 15 Gew.-% Ruß mit einer spezifischen Oberfläche von mehr als 100 m²/g, insbesondere etwa 1000 m²/g eingesetzt werden.
- Verwendung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Leitfähigkeitszusätze mit Dispergier mitteln, wie z.B. Siloxanen, eingebracht werden und eine maximale Teilchengröße von 25 μm aufweisen.
- 5. Verfahren zur Herstellung eines resistiven Feuchtigkeitssensors, dadurch gekennzeichnet, daß quellfähige Kunststoffe, 25 insbesondere Polyimide und/oder Copolyimide in einem polaren Lösungsmittel, wie z.B. N-Methylpyrrolidon, gelöst werden, daß hierauf Leitfähigkeitszusätze, wie z.B. Ruß, in der Lösung dispergiert und homogen verteilt werden, und daß anschließend die Lösung auf einen inerten Träger (1) aufge-30 bracht wird und anschließend getrocknet wird.
- Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Trocknung in wenigstens zwei Stufen vorgenommen wird, wobei in der ersten Stufe bei Temperaturen zwischen 80° und 140°C,
 insbesondere 120°C, und in jeder weiteren Stufe bei einer um 50 bis 80°C erhöhten Temperatur getrocknet wird.

- 11 -

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die maximale Trocknungstemperatur kleiner 280°C, vorzugsweise etwa 260°C, gewählt wird.

5 8. Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der spezifische Widerstand des leitfähigen, quellfähigen Kunststoffes auf 0,5 Ω cm bis 50 k Ω cm, insbesondere 5 Ω cm bis 30 k Ω cm, eingestellt wird.

10

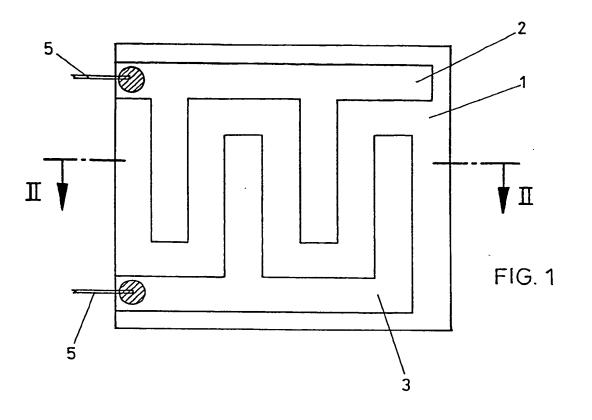
15

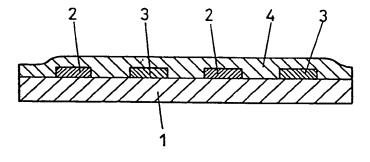
20

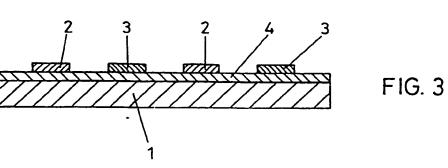
25

30

FIG. 2







Internationales Aktenzeichen PCT/AT 90/00084

	The malitage of the malitage of the stiffic at a state of the stiff all and	u Japan) ⁵
I. KLASSI	FIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mahreren Klassifikationssymboten sind alle anz Ir Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC	
	- 44 17 27/12	
Int.Cl	G 01 N 27/12	
II. RECHE	RCHIERTE SACHGEBIETE Recharchierter Mindestprüfstoff ⁷	
	Klassifikationssymbole	
≪lassifikatı	onssystem	
Int.CI	.5 G 01 N	
	Recherchierte nicht zum Mindestprofstoff gehorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen ³	
	nuial die techateurings ongrand	
	ACCEPTED COMPRGENS	
	CHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN ³ Kennzeichnung der Veröffentlichung ¹¹ , soweit erfordertich unter Angabe der maßgeblichen Teile ¹²	Betr. Anspruch Nr.13
Art*	Kennzelchnung der Verorientungs	i 1
x	US, A, 3848218 (WAKABAYASHI)	1,2
\ ;	12. November 1974 siehe Spalte 2, Zeile 29 - Spalte 4, Zeile	:
1	55; Spalte 9, Zeilen 13-34; Zusammenfassung;	1
	Figur 1	1
Y	rigur i	; 5 ; 3,4,6-8
A	·	3,4,0-0
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
\	GB, A, 1464605 (NIPPON SHEET GLASS CO.)	1,2
X	1 4 C Tabusa - 107/	i
	siehe Seite 3, Zeilen 40-90; Seite 4, Zeilen	:
\	71-90; Figuren 1,2	
A		3,5
		i
		5
Y	US, A, 4761710 (S.G.L. CHEN)	
1	2. August 1988 siehe Spalte 2, Zeile 46 - Spalte 3, Zeile 18	;
	siehe Spaite 2, Zeile 40 - Spaite 3, 2011	
	Zusammenfassung; Figuren 1-3 ./.	
"A" }	ondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 10. Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik "T" Spätere Veröffentlichung, die nach meldedatum oder dem Prioritatsoat ist und mit der Anmeldung nicht k	מונוחופרה נסתכפות השו בשה
"E" a	siteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna- Verstandnis das der Erstndung 20 Versta	orie angegeben ist
;	Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsansoruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung von besonderer Erweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung kann nicht als neu og weifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung kann nicht als neu og keit berühend betrachtet werden soll oder die aus einem	6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
1.	namtan Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem namtan Veröffentlichung belegt werden soll oder die ausgeführt) anderen, besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) anderen, besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	Sedeutung; die beanspruckerfinderischer Tätigkeit b
1	Veröffentlichung, die sich auf eine müncliche Offenbarung, ruhend betrachtet Werden, wirden, einer oder mehreren andere Maßnahmen einer oder mehreren andere Veröffendung gebracht wirden, wir	Heartica, acen dieser Kar
"P"	Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldeda- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritatsdatum veröffent- tum, aber nach dem beanspruchten Prioritatsdatum veröffent-	
٠ ــــــ	licht worden ist	
IV. 6	BESCHEINIGUNG Absendedatum des internationalen Recherche	echarchenoerichts
	Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherche	
	30. November 1990 18. 12. 90	riant: 2:30
<u> </u>	Internationale Recherchenbehorde Unterschrift das bevollmachtigtan 2s	11-100
	I was a second of the second o	びていまん
1	Europäisches Patentamt H. Ballesteros	

Art *	Kennzeichnung de	TLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)		90/00084
:		r Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe de	r maßgeblichen Teile 🕴 Be	tr. Anspruch Nr
A				
į		٠		2
A :	ווק א אבר	22722 /=		
		32728 (P.E. THOMA) 11 1971		1,2,5
;	siehe	Spalte 2 Zeilon 2 Ze -	•	. , . , .
ļ	Figure	n 1,2	mmenfassung;	
]				
				•
İ		•		
ĺ			•	•
		·	}	•
1				• •
İ				
ĺ				· •
İ				· ".
		·		٠.
				:
-				
			1	
				į. Į
İ				
1		·		
1				
İ				• -
				••
				.,.
				•
				:· [
				j
			1	.
1				- 1
1				1
		-		-
]				1.
ì			i	1



ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

AT 9000084 SA 39953

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 11/12/90 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US-A- 3848218	12-11-74	JP-A,B,C49067685 CA-A- 989478 DE-A- 2347389 FR-A- 2199886 GB-A- 1445694 NL-A- 7312998	01-07-74 18-05-76 28-03-74 12-04-74 11-08-76 22-03-74
GB-A- 1464605	16-02-77	JP-A- 50098390 JP-A- 50101083 JP-A- 50126075 JP-A,B,C50038236 JP-A,B,C50075480 DE-A- 2439119 FR-A,B 2241070 US-A- 3983527	05-08-75 11-08-75 03-10-75 09-04-75 20-06-75 27-02-75 14-03-75 28-09-76
US-A- 4761710	02-08-88	Keine	
US-A- 3582728	01-06-71	DE-A,B,C 2010220 FR-A,B 2034689 GB-A- 1297014	17-09-70 11-12-70 22-11-72

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (DEP).